



# 2022年3月期 第2四半期 決算補足説明資料

JASDAQ 証券コード：6614

2021年11月

## 売上高および各利益とも概ね計画以上の進捗

当社の売上・利益は第4四半期に集中する傾向があり、今第2四半期は軟調を予想していたが、予想を上回る進捗となった。

売上高は、新型コロナウイルス、材料納期遅延の影響を受けたが、2Q計画比増収。経常利益は、高付加価値製品への取り組み、コスト削減の取り組みを行ったことにより、2Q計画比増益。下期のウェイトが高いが、通期での進捗は50.3%と順調。

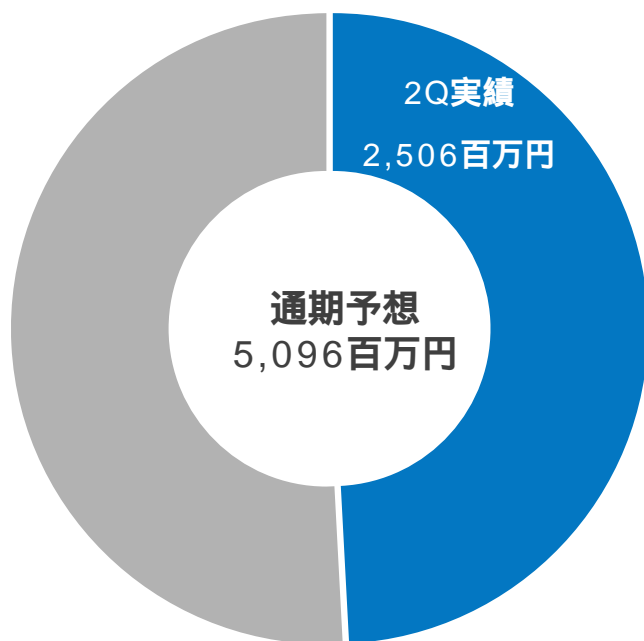
受注は好調であり、業績の上振れ可能性があるが、部品の長納期化の影響を考慮し、業績見通しは据え置く。

(単位：百万円、%)

	2022年3月期 業績予想 (8/11修正)	2022年3月期 1Q (4~6月)	2022年3月期 2Q単独 (7~9月)	2022年3月期 2Q (累計)	業績予想比
	金額	金額	金額	金額	進捗率
売上高	5,096	1,167	1,339	2,506	49.2
営業利益	280	43	87	130	46.5
営業利益率	5.5	3.7	6.5	5.2	—
営業外損益	6	2	11	13	226.7
経常利益	286	44	99	143	50.3
減価償却費合計	122	22	25	47	38.5
当期純利益	200	15	70	85	42.8

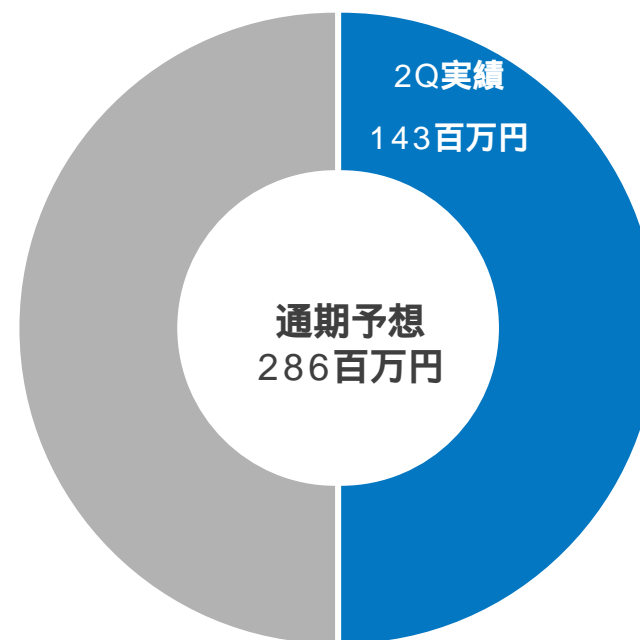
【売上高】

(単位：百万円)



【経常利益】

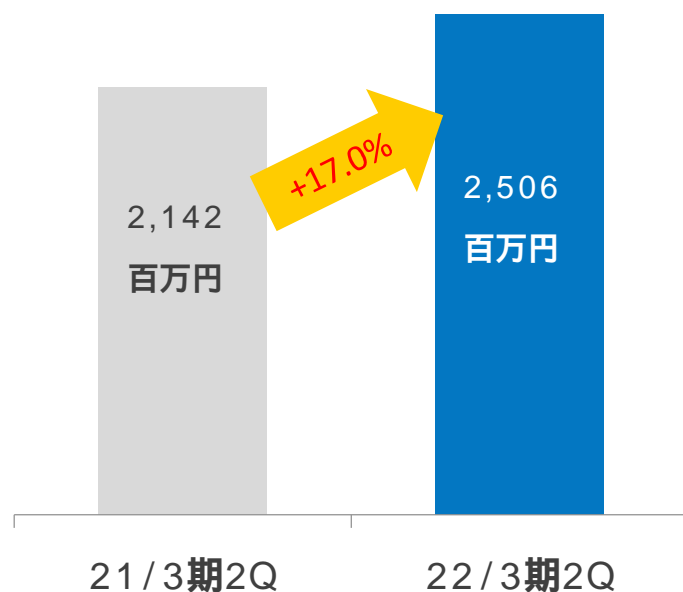
(単位：百万円)



売上高・経常利益ともに4Qに偏重する傾向がある。  
2Qまでの実績は順調に推移

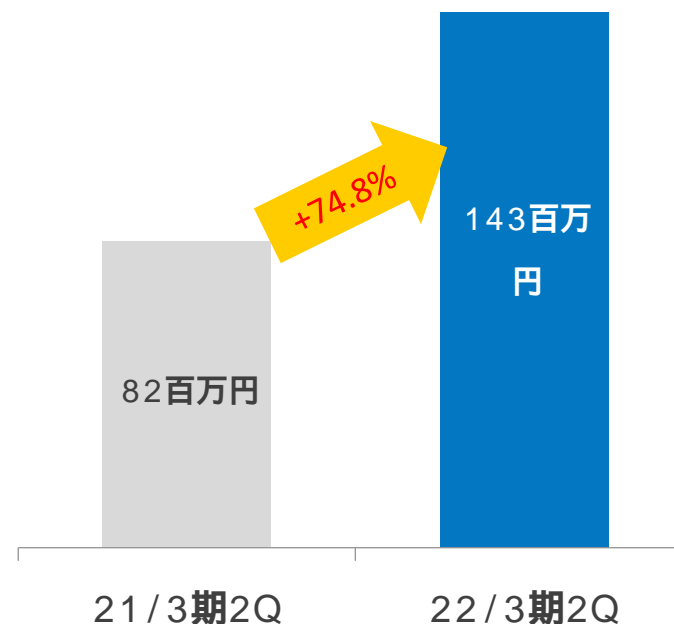
【売上高】

(単位：百万円)



【経常利益】

(単位：百万円)

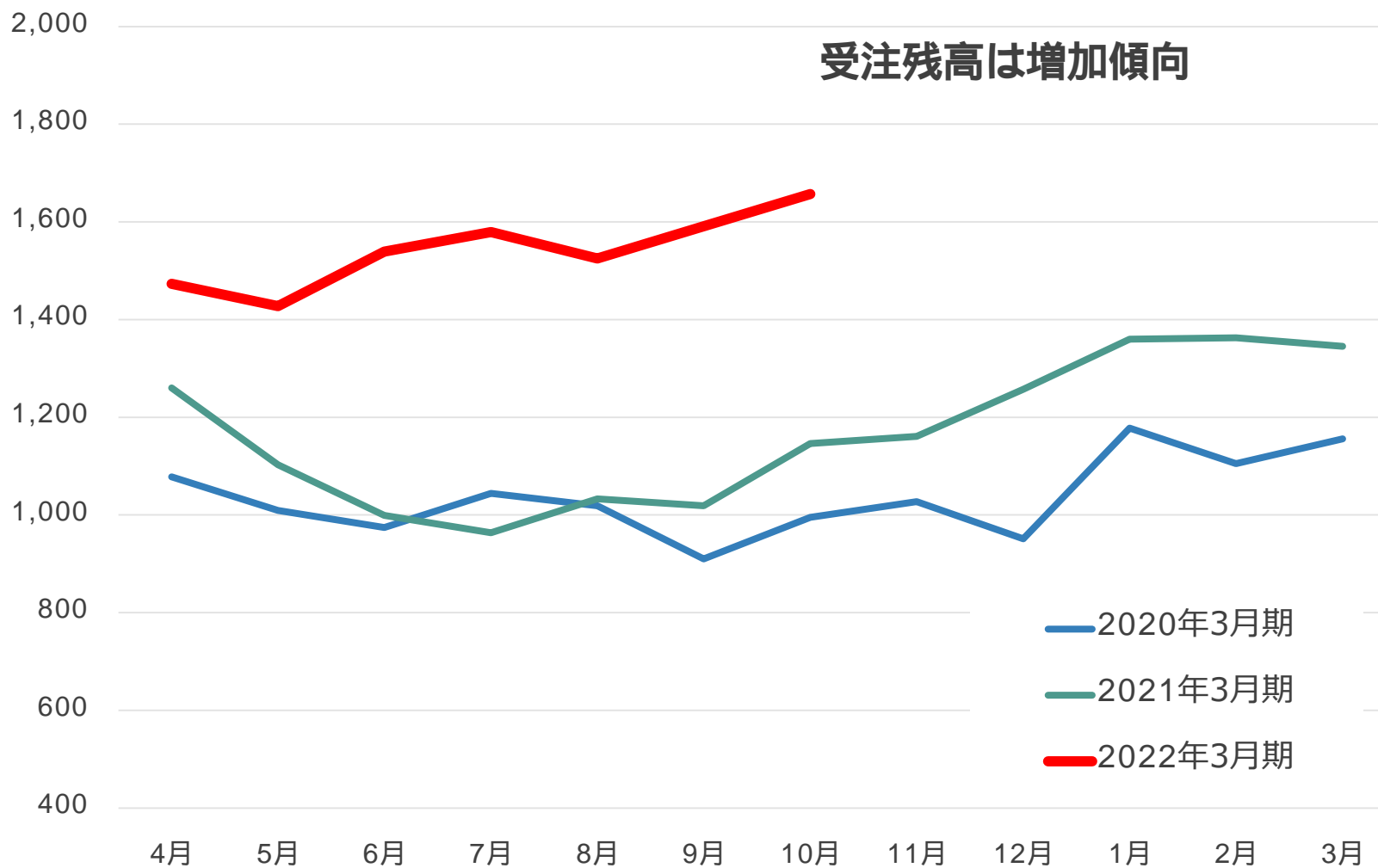


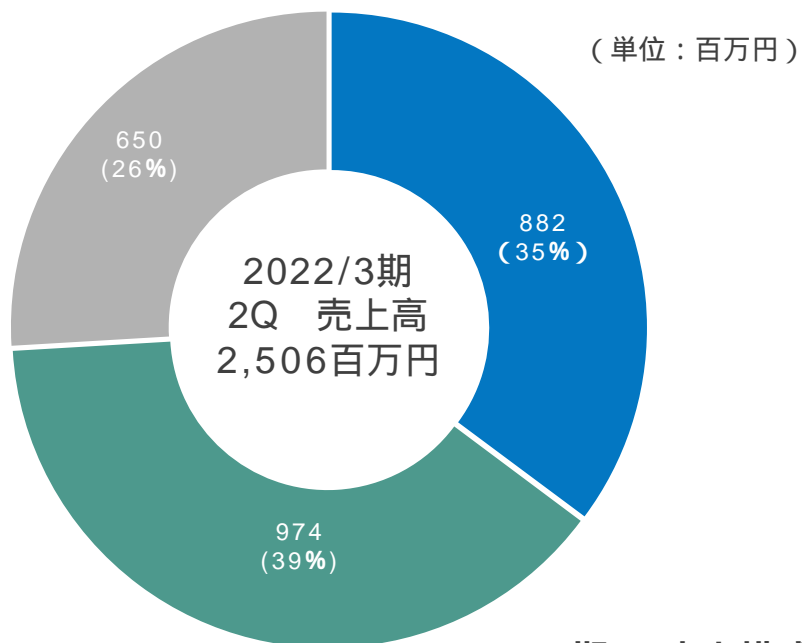
売上高・経常利益とも前年同期比で増収増益で推移

(注) 21/3期2Qは未上場であり、四半期財務諸表を作成しておりませんので、参考数値となります。

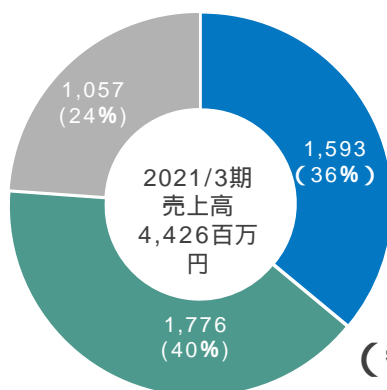
【受注残高(全社)】

(単位:百万円)





22/3期2Q売上構成



(参考) 21/3期売上構成

## 電子システム事業

### 半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

## マイクロエレクトロニクス事業

### LSI設計(アナログ・デジタル)、IP開発

電源IC設計、高速I/F回路設計、イメージセンサ回路設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計  
JPEG、MIPI、IPコア

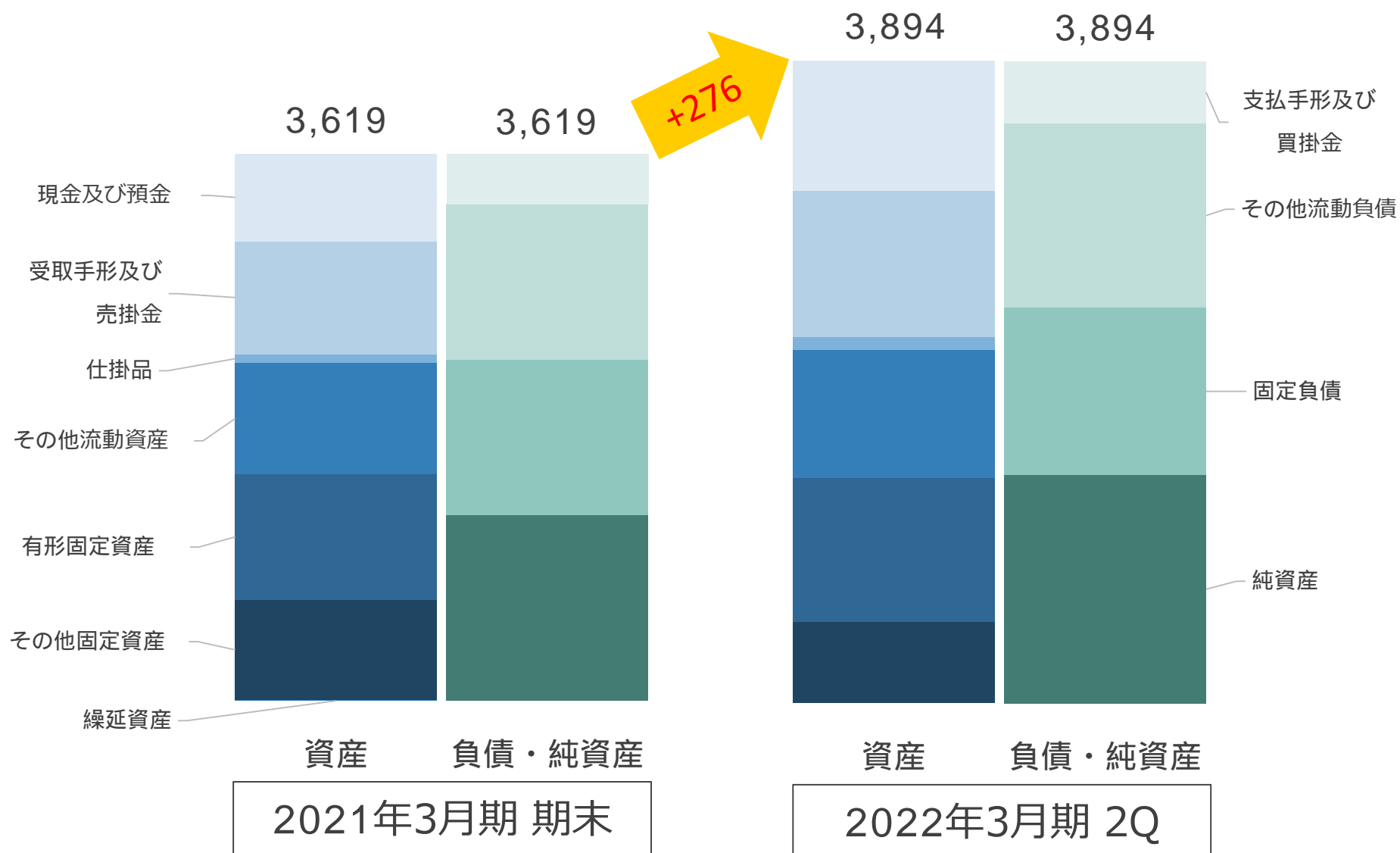
## 製品開発事業

### 画像関連機器開発

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

# 貸借対照表

(単位：百万円)

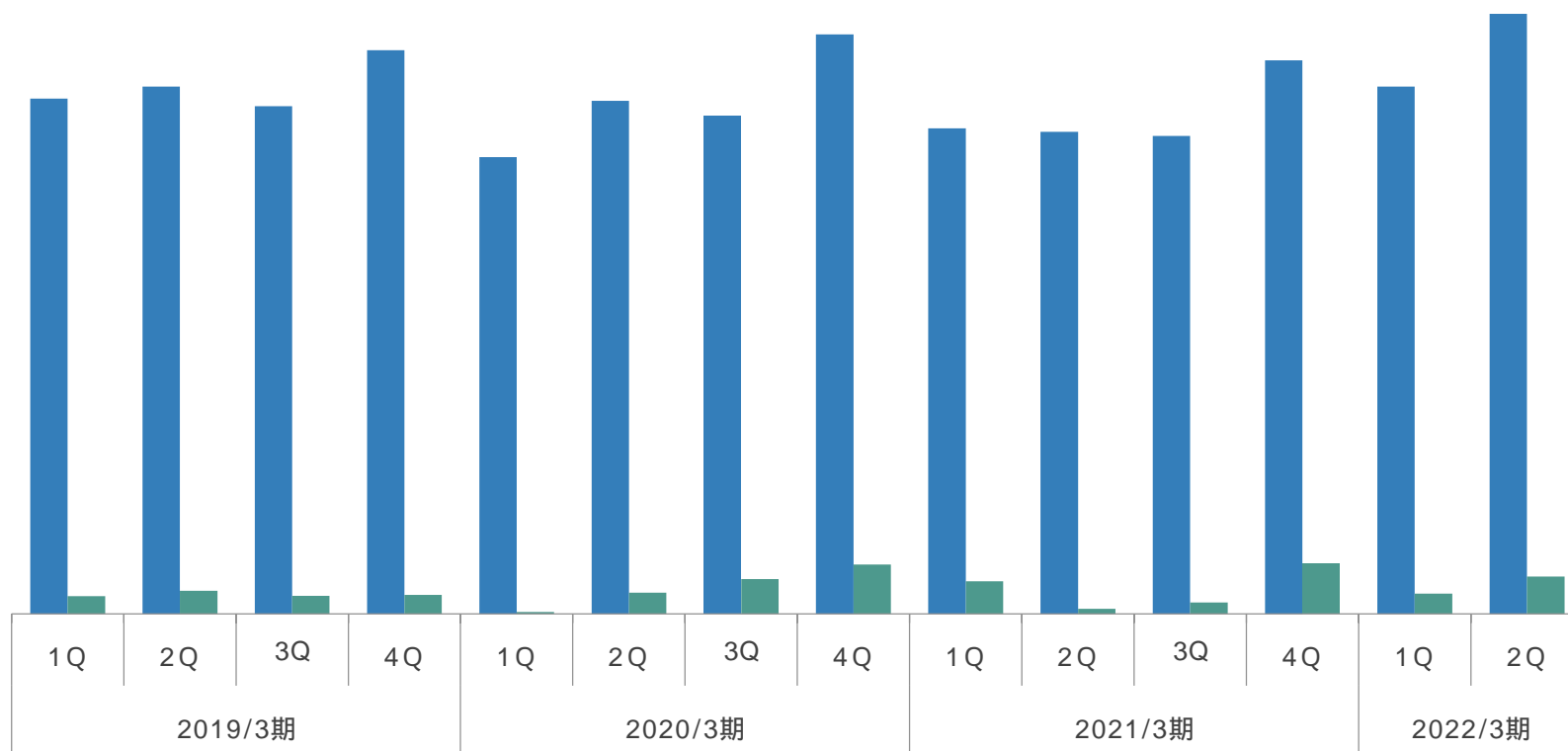


2021年	4月21日	第三者割当増資	
	5月14日	決算発表	1Q
	6月11日	決算説明会	
	6月28日	第49期 定時株主総会	
	7月 9日	東京証券取引所より「新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果」の適合通知を受領	2Q
	8月11日	第1四半期 決算発表 通期利益を上方修正	
	10月18日	東京証券取引所の新市場区分 「スタンダード市場」選択を開示	3Q



顧客のプロジェクト（製品開発等）サイクル、当年度の量産開始が下期から開始する傾向などにより、売上・利益ともに4Qが最も高くなる傾向

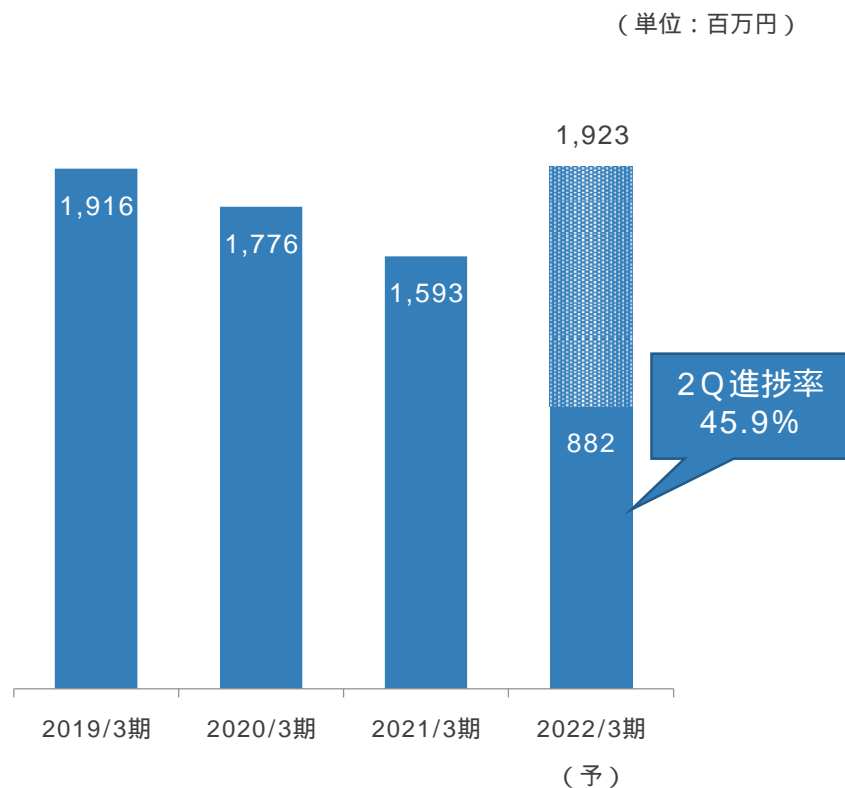
■ 売上高 ■ 経常利益



経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

計測・制御・通信をコア技術に、開発～ものづくり～保守・メンテナンスまでトータルで半導体検査装置・産業機器を提供

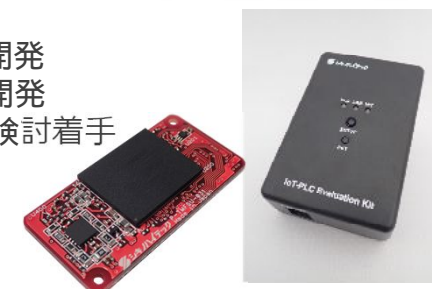
## 【売上高】



## 2Qトピックス

### IoT-PLC通信モジュール

- ・広帯域電力線搬送通信設備型式指定を取得
- ・HD-PLCアライアンス加入
- ・高速電力線通信推進協議会加入
- ・製品市場投入、顧客サポート開始
  - 評価機貸出し
  - 周辺機器カスタム開発
  - 応用製品POC受託開発
- ・次世代標準モデル開発検討着手



### バーンイン装置

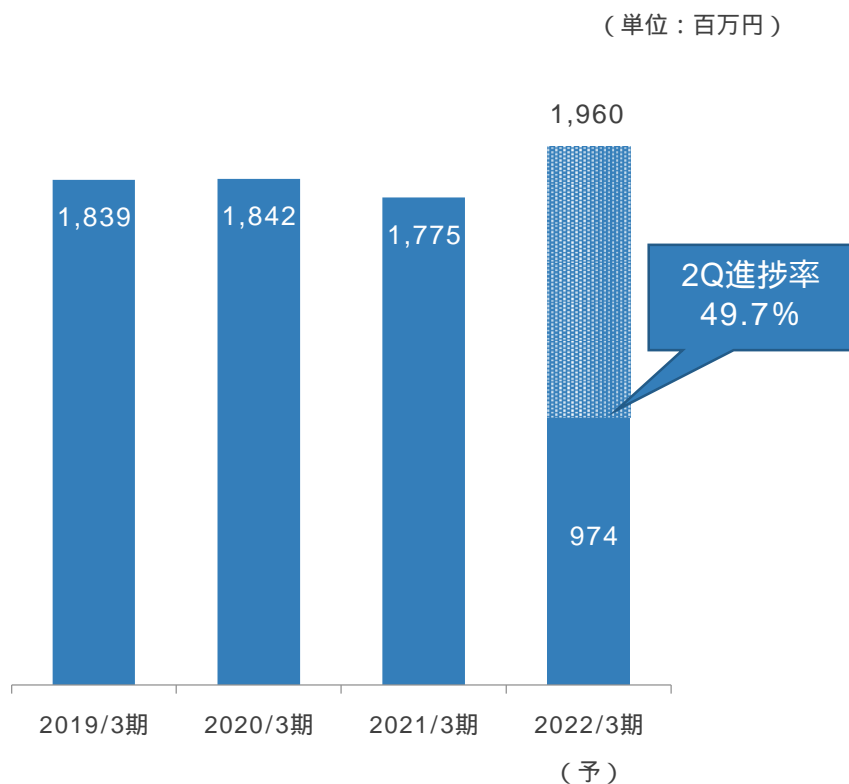
- ・リース機増大・拡充
- ・受託試験適用デバイス範囲拡大
- ・中古装置事業本格開始



高速インターフェース技術、電源技術、画像処理技術を強みにモバイル、車載機器分野などに向けた半導体のアナログ設計、デジタル設計及びIPコアや評価サービスを提供

## 2Qトピックス

### 【売上高】

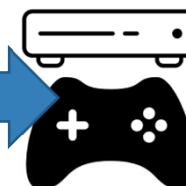


#### ➤ アナログ半導体設計受託

スマートフォン向けセンサ関連  
アナログ設計受託  
(前年下期比：114%)



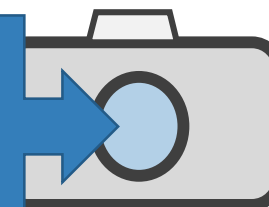
汎用商品向けパワー半導体関連  
アナログ設計受託  
(新規受託)



#### ➤ デジタル半導体設計受託

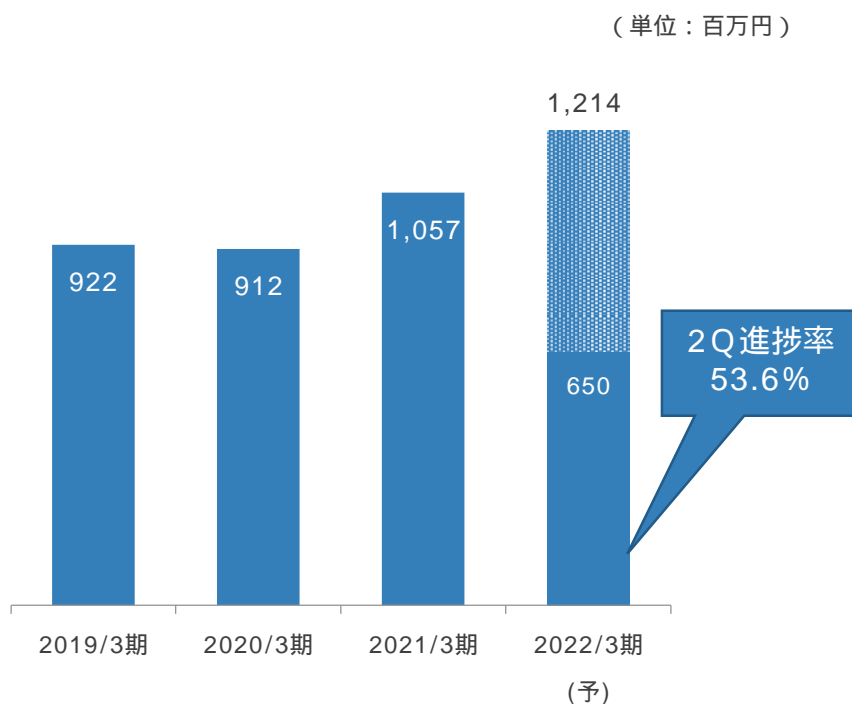
画像処理関連LSIの設計受託が堅調に推移  
大型案件を受注

DSC向け画像処理関連  
デジタル設計受託  
(前年下期比：428%)



コンビニATM等社会インフラ分野から応用製品（医療・介護関連：ビュー+センシング）へ展開  
組み込みカメラシステム分野での光学・電子回路・ソフトウェアトータルでの技術力が強み

## 【売上高】



## 2Qトピックス

### ➤ ヘルスケア産業育成創出事業 採択

- ・採択機関：公益財団法人 富山県新世紀産業機構
- ・テーマ名：機械学習を用いた、廉価 / 高性能 見守りシステム向け遠赤外線体表面温度推定の精度向上に関する研究
- ・採択時期：2021年8月～2022年2月

### ➤ オンライン販売ショップ「チップワンストップ」にてカメラ製品の取り扱いを開始

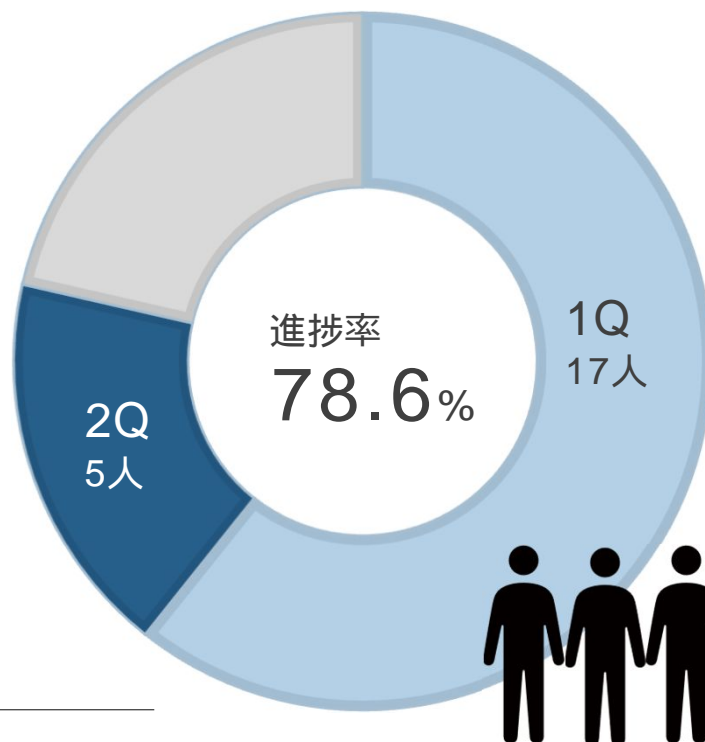
- ・オンライン販売先：株式会社チップワンストップ  
日本国内最大級の電子部品通販サイト  
[www.chip1stop.com](http://www.chip1stop.com)
- ・取り扱い製品名：KBCR-S03TU  
200万画素高感度USBカメラ
- ・取り扱い開始時期：2021年9月
- ・WEBセミナー登壇：同社主催「エッジAI 2021」にて画像センシングカメラを講演



半導体事業における増産に対応するため、  
人員増強を図る。  
通期で28人の計画に対し、2Qまで22人  
増員。

人員

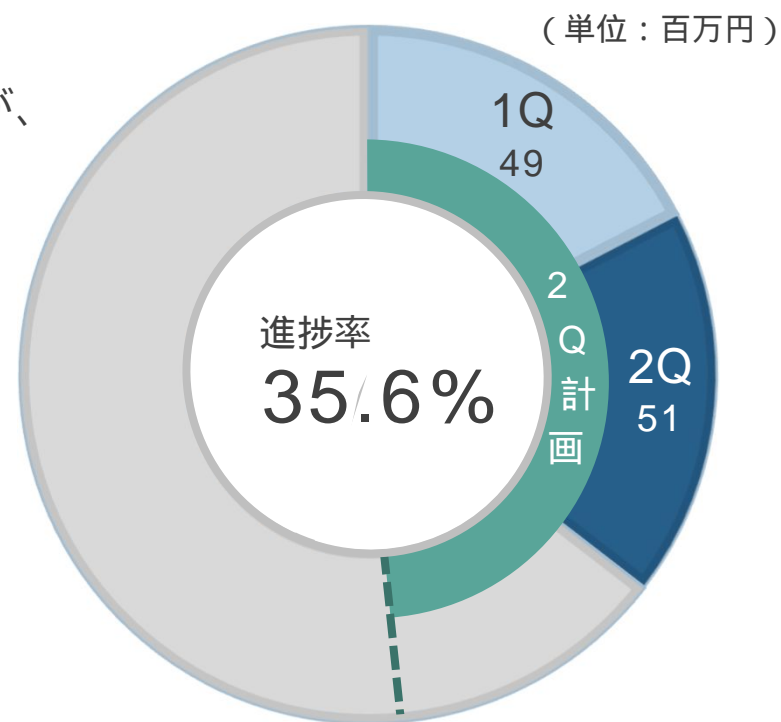
通期計画：28人



開発テーマの入れ替え、早期事業化により  
年間の研究開発費投下の進捗が遅く見えるが、  
大幅な遅れは生じていない。

## 研究開発費

通期計画：282  
(うち、2Q計画：139)



顧客の未解決課題の解決、顧客ニーズの充足の視点で、競合他社に対して優位性のある技術・製品の開発に取り組む

## 研究開発分野

半導体検査装置、計測システム、  
IPコア、高速IF回路、  
画像処理システム、カメラの性能向上、  
新機能開発

### 電子システム事業

・半導体検査装置・個別温調装置・HD-PLC

### マイクロエレクトロニクス事業

・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア

### 製品開発事業

・エッジAIカメラ・高画素インテリジェントカメラ・介護向けシステム

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

## 【お問い合わせ先】

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail : IR-contact@shikino.co.jp

TEL : 0765-22-3477 FAX : 0765-22-3916

ホームページ : <https://www.shikino.co.jp/>